

張貼日期：2022/05/19

【資安漏洞預警】Intel修復多項晶片韌體高風險漏洞

- 主旨說明Intel修復多項晶片韌體高風險漏洞
- 內容說明：
 - 轉發 科學園區資安資訊分享與分析中心 SPISAC-ANA-202205-0008
 - Intel在5月10日出安全更新，以修補存在於資料中心、工作站、行動裝置等平臺的晶片韌體漏洞。
 - 在所有受影響的產品中，iPU-BIOS存在11項漏洞，包括輸入驗證不當[CVE-2021-0154]、越界寫入[CVE-2021-0153]、存取控制[CVE-2021-33123]及未捕捉例外CVE-2021-0190 [Uncaught exception]等4項風險等級8.2的漏洞，後果為造成攻擊者擴張權限或資訊洩露。另5個漏洞則涉及本機權限升級[LPE]，風險值在7.4到7.9之間，分別為CVE-2021-33122、CVE-2021-0189、CVE-2021-33124、CVE-2021-33103、CVE-2021-0159。
- 影響平台Intel處理器7-10代，含Rocket Lake及Xeon Scalable伺服器端Core Processor with Hybrid Technology行動處理器。
- 建議措施：請至Intel Security Center 查看相關修補措施。
- 參考資料：
 1. <https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/default.html>
 2. <https://www.ithome.com.tw/news/150953>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailling:announcement:20220519_01

Last update: **2022/05/19 16:48**

